



HJT 硅片链式吸杂前清洗设备

HJT Wafer Chain Cleaning Equipment

特点描述

- 高温工艺槽采用隔热腔结构，防止塑料高温变形；
- 传输轨道由紧固安装方式代替传统焊接安装方式；
- 采用线性开口，高气流、低压力干燥切水风刀；
- A/B侧独立控制，独立工艺调试。

Features

- Insulating chamber structure prevents deformation;
- Transfer rails installed in a fastening manner;
- Linear opening, high airflow, low pressure dry water cutter;
- Independent control and process debugging on A/B side.

技术性能

产能>14400片/小时，210×105硅片；
硅片采用16道传输；
传输速度3.7m/min；
碎片率<0.3‰；
腐蚀量0.2g。

Performance

Capacity> 14,400 pcs/h, 210×105 silicon wafers;
16 way silicon transfer;
Transfer speed 3.7m/min;
Breakage rate< 0.3‰;
Corrosion amount 0.2g.

技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
清洗流程 Cleaning process	Polish→DHF→DRY